

多層基板外周仕上切断機 **HME-650W/WF**

■ HME-650WF仕様

加工仕上げサイズ	幅300~620mm 長さ300~520mm 板厚0.16t~3.2(5)t
切断端材寸法	最大40mm
カッター	φ120×30P 4枚 6000RPM 0.4Kwベルトドライブ4軸
切断移動速度	パソコンからファイルごとに設定 標準 30m/min
走行速度	最大速度 80m/min
基準穴検出カメラ	CCDカメラ 視野約30×30mm 分解 7μ 1カメラで2穴検出 基準穴 15種類登録して、加工ファイルで任意に設定します
加工能力	13秒以下/1枚 (2.0以上は遅くなります) 11秒以下/1枚をご希望の場合はHME-650WF型を検討ください
加工精度	切断外形寸法 ±100μ以内 (1.0t厚さ) 対角 ±300μ以内 基準穴から切断辺寸法 ±300μ以内
ユーティリティ	電源 AC200V-3P 5.2Kw (集塵機は含みません) AC100V-1P 0.5Kw パソコン専用電源 エア- 100Nℓ/min 0.5Mpa 常温ドライクリーンエア-
パソコン仕様	OS Windows モニター 17インチ液晶 CPU 1.3GH以上 HDD80GB以上を使用しています
オプション	集塵機 2.6kPa以上 40M3/min

■ オプション



HKI-650 刻印板厚複合機



HKO-650FAR 全自動刻印機



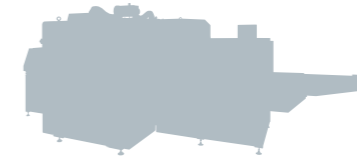
HCR-650F4 コーナー面取機

■ HME-650WFとHCR-650F接続例



HME-650W/WF

多層基板外周仕上切断機



多層プレス後の外周切断の改革をご提案します。特許出願済
驚きの省エネマシン。多層プリント基板の外周仕上げ加工形状が変わりました。

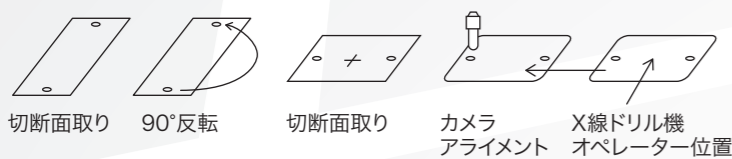
特徴

- 1 ソフミックス独自の切断面取り加工方法でハロゲンフリー材・テフロン材等、材料を選ばない、新切断方式が排出粉塵量を大幅に削減することができます。
- 2 銅箔から厚板まで、スリッターを使わない完全切断が実現、端材トラブルから開放されます。
- 3 2ヶ所の基準穴をCCDカメラで検出し、外周の仕上げ切断をします。
- 4 機械のコンパクト化と軽量構造設計・切断方式の改革で駆動動力源の最小最適化を実現。弊社のHMC旧型機と比較して、実に50%以上の電力削減を可能にしました。実測、約5A以下(AC200V3P)の省エネ運転が実現しました。
- 5 設置スペースを40%ダウン(弊社従来機比較)を実現しました。
- 6 当機のパソコンからネットワークする後接続機の一元管理が実現します。
- 7 X線穴明け機と連結で、後工程の完全無人化が実現しました。

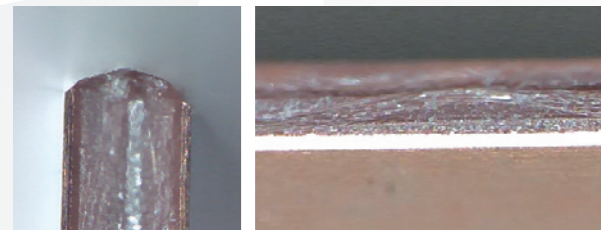
仕上げ加工される形状の比較



加工の流れと状態



加工例



ダクトホースガイド
集塵ホースの破損防止対応



カメラアライメント部

X線穴明け機 多層基板投入位置

NG取出し及び投入パット部

板厚さ
0.16~3.2tが可能

加工速度
650W=1枚/13秒以下
650WF=1枚/11秒以下

切断部



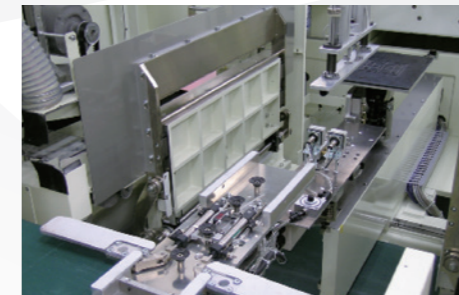
切断仕上げした端材はチャックが確実に取出します。銅箔が切れないトラブルから解放されます。

搬送テーブル部(650WF)



簡単に交換が出来る搬送吸着テーブル

薄板対応、搬出パット部(650W)



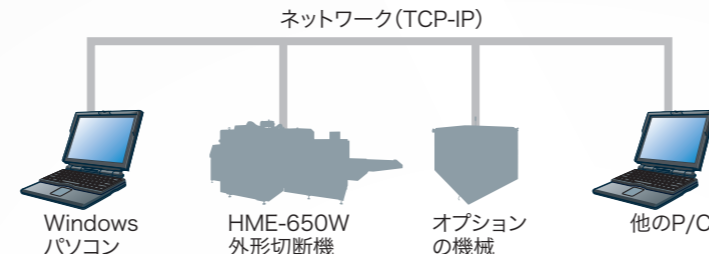
薄板加工時には基板受けが動作して、板垂れを防止します。

カメラアライメント部



カメラ視野は30mm×30mmと拡大しており、視野ズレNGを防止しました。

ネットワーク



データ編集入力

